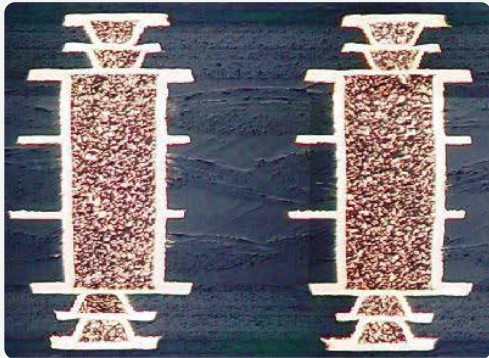


基板用導電銅膏

使用用途廣泛，民生用品到高科技產業都有使用實績

用途

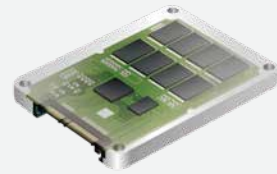
上下層散熱和導通



基板斷面圖

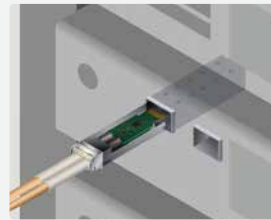
民生用品

圖：SSD



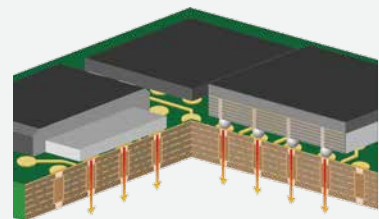
通信設備

圖：光纖傳輸



特性

- 對應各種基材或銅箔都有良好的密著性
- 具有安定的導通性
- 具有高散熱性 (AE7332 - 導熱性 38W/mk)
- 不含溶劑，可有效壓制空洞的發生
- 可有效幫助高密度上件和堆層 (Build-up) 等相關設計
- 擁有多種導電膏型號，適合對應多種需求



散熱圖

產品型錄和特性表

產品型號			AE1244	AE2217	AE1650	AE3030	AE7332
黏度	BH型	dPa·s	800 ~ 1,400	1,600 ~ 2,200	1,300 ~ 1,800	1,200 ~ 1,800	900 ~ 1,500
固化條件	預熱		80°C × 30分	60°C × 30分	80°C × 30分	60°C × 30分	80°C × 30分
	完全固化		160°C × 60分				
體積阻抗率		Ω·cm	1.00E-04			2.00E-04	5.00E-05
熱傳導係數 (Laser flash method)		W/m·k	11.7	13.5	16.5	7.8	38
玻璃轉化溫度		°C	110	113	95	171	56

